

杭州晶华微电子股份有限公司

2025 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告

杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）为积极响应落实关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，结合自身发展战略和经营情况，于 2025 年 4 月 19 日发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，共同促进科创板市场平稳运行。2025 年上半年，公司以行动方案及整体战略为指引，积极推动并落实相关举措，现将上半年的具体情况公告如下：

一、研发销售并进，推动业务成长

2025 年上半年，由于 4 月美国加征关税政策扰动，公司智能健康衡器芯片、数字万用表芯片和智能家电控制芯片的市场需求受到部分抑制，但是公司迅速调整市场策略，全力以赴，报告期内实现营业收入 7,862.26 万元，同比增长 30.68%；归属于上市公司股东的净利润-2,296.17 万元，同比下降 600.18%；剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润为-1,383.59 万元，同比下降 672.25%。

（一）业务发展动态

2025 年上半年，公司持续深化高性能模拟及数模混合集成电路领域的技术创新，围绕医疗健康、工业控制、智能家电及电池管理四大核心领域，加速推进新产品研发与量产进程。报告期内，公司研发费用 4,619.39 万元，同比增长 43.11%；研发投入占营业收入的比例为 58.75%；至报告期末公司研发人员 141 人，研发人员数量占公司总人数 62.67%。同期，在研芯片项目数量较去年同期增长 35.00%，流片次数提升 140.00%，公司已完成多款关键产品的流片与测试验证，预计将于下半年陆续实现小规模出货。

在医疗健康领域，公司带 HCT（红细胞压积）功能的血糖仪专用芯片实现技术突破，该芯片基于 8 位 MCU 内核，集成 24 位高精度 ADC 及生化电化阻抗测量模块，测量精度满足 ISO15197:2013 国际标准，报告期内已向国内知名头部客户完成批量交付，市场份额进一步提升。同时，公司也积极推动血压计芯片解决方案的市场普及，加速在品牌客户中的推广采纳。公司始终密切关注人体健康参数

测量领域的最新动态，紧密贴合客户需求及市场趋势，持续不断地研发新品并迭代更新医疗健康 SoC 芯片，以保持技术创新与市场领先地位。

报告期内，公司工业控制芯片收入同比增长达 30.35%，主要系公司大力推广新一代变送器单芯片解决方案和 4-20 mA 电流环 DAC 芯片解决方案，2025 年上半年实现了大客户突破并已规模出货。公司深度聚焦于客户产品应用的核心痛点及系统技术的最新演进趋势，且提供端到端一站式解决方案，以创新性设计方案匹配不同客户的定制应用需求，逐步替代国际厂商的同类产品。在仪器仪表芯片产品方面，由于细分领域市场需求趋好且公司的万用表 SoC 芯片已在行业内建立起一定的知名度，公司把握机遇，匹配客户需求，不断巩固和补充垂直市场的应用方案，持续扩大市场占有率。

智能家电方面，2025 年上半年，晶华智芯 78 系列高性能触控显示智能控制芯片及 72JE 系列高性价比小家电触控芯片均已完成流片并验证成功，将于下半年推出量产样品。报告期内，晶华智芯 DIN 和 DWIN 项目个数均较去年同期增长 60%以上，2024 年度推出的 72H 系列产品已在苏泊尔、长虹美菱，澳柯玛小规模批量量产，此外 73 系列产品在美的厨卫小规模出货，本报告期晶华智芯也开拓了多个上市公司、知名品牌新客户，陆续开展项目导入中。

2025 年上半年，依托前期持续研发投入及成都分公司高端人才引入，公司在电池管理产品线实现全链路覆盖，形成了从单节高精度锂电保护芯片到 17 串 BMS 模拟前端芯片的完整解决方案布局，公司产品满足了消费电子、电动工具，智能清洁家居到轻型电动车、无人机和储能系统等多元化应用场景的需求，下半年公司将进一步推出多款专用型芯片，支持更高串数以及集成度更高、具备云端通信的智能 BMS 平台解决方案。公司聚焦高端电动工具，电摩与储能等应用，持续拓展新能源领域技术纵深。基于公司产品具有高精度、高可靠性，超低功耗，方案整合能力强等核心竞争优势，公司能够为客户提供性能卓越、安全可靠且极具性价比的 BMS 芯片及方案。公司 BMS 芯片已成功导入多家客户实现批量出货，并逐步导入行业头部客户和知名终端品牌，产品性能与可靠性得到市场验证和认可。

（二）日常经营管理

1、公司新设技术创新中心与质量与可靠性中心，构建“技术革新×品质护航

”的双擎驱动。技术创新中心将以市场导向为研发指针，通过产学研合作与跨学科技术融合，聚焦前沿技术攻关与产品迭代升级，打造差异化技术护城河；质量与可靠性中心将深入产品全生命周期管理，建立“预防—监控—改进”的质量防火墙，以高标准的可靠性测试体系为产品竞争力托底。

2、进一步优化供应协同和库存管理。一是加强供应商合作，与核心供应商建立长期稳定的伙伴关系，升级生产运营与质量管理体系，保障产能稳定与交付可靠性；二是动态调整库存，根据市场需求变化灵活管理库存水平；三是完善风险应对机制，进一步优化采购、生产和库存流程，保障供应链安全，提高整体效率。通过综合措施，力争实现降本增效目标，为客户提供更可靠的产品和服务。

3、公司高度重视规范运作，将持续强化合规运作与内部控制体系建设，稳步提升公司管理水平，健全公司内部控制体系。公司通过完善风险预警机制、强化内部审计及合规培训，确保经营决策透明化、流程执行规范化，有效防范技术泄密、库存积压等潜在风险。

4、公司着力优化管理机制，激发组织活力，为可持续发展注入动能。一是搭建高效沟通平台，推行跨部门信息共享系统与定期交流机制，提升协作效率；二是完善人才激励体系，强化梯队培养，将逐步建立分层培训体系，建设清晰的职业晋升通道，提升员工积极性；三是深化员工关怀，在保障物质的基础上，给予多维度的关怀支持，增强归属感。

二、实施战略并购，增强精管协同

报告期内，公司围绕“精管协同”原则，系统推进与新团队的整合管理。一是平衡管控与创新，在财务风控等核心制度上快速对齐，同时保留新团队原有灵活机制，形成既规范有序又激发活力的管理模式；二是推动资源共享，整合双方研发资源与客户渠道，建立统一技术平台和共享供应链池，减少重复投入，提升业务协同效率；三是强化团队融合，通过项目交流、团建活动等多种方式增进沟通，并为新团队提供发展空间，逐步消除文化差异，凝聚共同目标。通过制度衔接、资源整合与文化包容的三重举措，实现管理成本降低与协同价值释放的双重目标。

三、加强募投项目管理，加快经济效益释放

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 59,537.39 万元（包括累计收

到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，公司募集资金实际使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	92,053.70
截至期初累计发生额	项目投入	B1	14,597.05
	股份回购	B2	2,198.47
	利息收入净额	B3	3,631.20
	永久补充流动资金	B4	10,200.00
本期发生额	项目投入	C1	4,394.31
	股份回购	C2	0.00
	利息收入净额	C3	342.32
	永久补充流动资金	C4	5,100.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	18,991.36
	股份回购	D2=B2+C2	2,198.47
	利息收入净额	D3=B3+C3	3,973.52
	永久补充流动资金	D4=B4+C4	15,300.00
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3-D4	59,537.39
实际结余募集资金		F	59,537.39
差异		G=E-F	0.00

自首发募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施工作，但由于半导体市场周期性调整及需求结构性下滑，全球消费电子市场需求疲软，当前半导体行业仍处于去库存阶段，客户订单需求放缓。公司结合募投项目对应市场的实际需求情况，基于合理有效使用募集资金的原则，在募投项目的推进上更加谨慎、严谨、科学，整体进度较原计划放缓，以有效控制成本、降低风险、提高资产流动性。公司于 2025 年 7 月 10 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2025 年 7 月 29 日召开了公司 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的议案》，“智慧健康医疗 ASSP 芯片升级及产业化项目”“工控仪表芯片升级及产业化项目”“研发中心建设项目”实施期限延长至 2027 年 7 月，“高精度

PGA/ADC 等模拟信号链芯片升级及产业化项目”终止实施，“研发中心建设项目”增加实施主体全资子公司深圳晶华智芯微电子有限公司，增加实施内容智能家电控制芯片的开发设计研究。公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	总投资额	原计划投入募集资金	调整后投入募集资金	实施主体
1	智慧健康医疗ASSP芯片升级及产业化项目	21,089.00	21,089.00	21,089.00	杭州晶华微电子股份有限公司
2	工控仪表芯片升级及产业化项目	19,069.00	19,069.00	19,069.00	杭州晶华微电子股份有限公司
3	高精度PGA/ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目	17,519.00	17,519.00	终止实施。截至2025年6月30日，项目实际投入募集资金3,155.10万元，公司将剩余募集资金继续存放募集资金专户并寻找新项目	杭州晶华微电子股份有限公司
4	研发中心建设项目	12,323.00	12,323.00	12,323.00	杭州晶华微电子股份有限公司,深圳晶华智芯微电子有限公司
5	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	杭州晶华微电子股份有限公司
	合计	75,000.00	75,000.00	75,000.00	-

四、规范内控管理，提升运营效率

报告期内，公司高度重视企业规范治理及合规运营效率，持续梳理公司内部控制设计及执行情况，不断优化和健全内控体系与制度流程。根据新《公司法》和《上市公司章程指引》等的修订情况，公司于2025年7月10日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，于2025年7月29日召开了公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、调整利润分配政策、取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》，公司将不再设置监事会，免去监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并完成了对《公司章程》及内部治理制度的修订和完善，确保公司内部控制的合规有效，进一步从制度建设层面夯实业务风险管控基础。

此外，公司积极深化独立董事履职机制，充分发挥独立董事在公司治理中的监督作用，听取独立董事对于公司加强内部控制风险防范机制的重要性的建议，

及时向独立董事报告公司的相关重大事项，保障独立董事的知情权、监督权，努力提升公司治理的合规性、有效性和开放性。公司亦积极组织董监高及相关工作人员参与证监会、交易所和各级上市公司协会等举办的培训，不断提升其专业素养和合规意识，以推动公司董监高尽职履责。报告期内，公司已组织部分董事和高管参加了关键少数信息披露规范运作专题培训、提质增效专题培训和并购重组专题培训等，深入学习证券市场相关法律法规，确保公司运作的规范性和合规性。

2025 年下半年，公司将根据监管新规、《公司章程》及内部治理制度的修订情况，积极强化和提升公司“关键少数”的合规意识与履职技能，推动公司治理水平的有效提升。

五、优化财务管理，增强组织效能

公司财务部门持续加强与各业务部门的紧密联系，对业务活动实质做到充分了解，切实提高会计核算的及时性和准确性，从源头保证财务报告信息质量；同时，加强公司财务部与会计师事务所等外部专业机构的日常沟通，对于存在不确定性的重大事项提前与会计师事务所进行充分沟通交流，寻求专业意见支持以提高财务信息的准确性，从内部和外部双管齐下，从而提升财务核算专业性、规范性。此外，依托现有的财务管理及业务管理系统，不断完善财务数据分析工作，为公司的经营发展提供强有力的财务数据支持，并运用财务数据分析及预测结果，合理规划资金的使用，通过多种途径降低运营成本，以提升公司的整体效益。

六、重视股东回报，共享发展成果

公司始终坚持投资者利益至上原则，在综合考虑公司实际情况、发展战略以及行业发展趋势的基础上，并且符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东利益，让投资者切实享受公司发展成果，提升广大投资者的获得感。

报告期内，为切实贯彻股东回报战略，基于 2024 年度经营业绩及财务状况，公司于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，不派发现金红利，不送红股。2024 年年度权益分派方案已实施完毕，公司总股本由 93,126,248 股变更为 120,891,094 股。具体内容详

见公司于 2025 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-029）。

七、提高信披质量，加强投关交流

报告期内，公司进一步加强信息披露的合规性，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，有效地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息，也借助新媒体平台工具，在合规范围内传递公司经营情况和技术创新等信息，扩大了信息传播的覆盖面，确保了信息披露的广泛性和平等性。同时，公司以投资者需求为导向，持续提升信息披露内容的可读性和有效性，切实维护投资者权益。

公司通过“上证路演中心”等平台举行了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，向投资者介绍公司财务数据表现，并就相关问题进行解答；组织、参加了近 10 场次的投资者沟通交流活动，将公司价值有效传递给资本市场，让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层；并通过投资者热线、E 互动平台、电子邮箱等多种形式，保持与投资者的交流。

八、强化利益共担共享，压实“关键少数”责任

2024 年 10 月 9 日，公司披露《关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-049），公司控股股东、实际控制人、董事长吕汉泉先生拟自 2024 年 10 月 9 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，本次合计增持金额不低于人民币 1,500 万元，且不超过人民币 3,000 万元。截至 2025 年 3 月 28 日，增持主体累计增持公司股份 571,200 股，增持金额合计人民币 15,318,585.08 元（不含交易费用），增持计划已实施完毕。

2025 年 3 月公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，公司为满足归属条件的激励对象办理了股票归属登记事宜。增持计划、股票激励计划能进一步激发公司股东、管理层及员工等的责任感、使命感，强化目标责任意识，使其利益与公司长远发展有机结合，提升公司发展质量，增强投资者回报，切实强化管理层及核心骨干与股东利益的共担共享。

此外，报告期内公司控股股东、实际控制人在业务、人员、资产等方面与公司保持独立，不存在侵占公司资产、损害公司利益的情况。公司通过培训、合规

提醒等方式提升公司董监高的合规意识和履职能力，通过独立董事等多层级多维度对“关键少数”人员在公司核心重点领域进行监督，持续督促董监高忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项声明和承诺。

后续，公司亦将强化管理层及公司核心骨干与股东利益共担共享约束机制，严格实施考核，持续提升高管的管理水平和业务能力，优化薪酬激励与约束，依法合规探索长效激励机制，实现利益绑定，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当。

九、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，履行上市公司责任和义务，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，未来可能受到宏观政策调整、行业环境变化等因素变化的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

杭州晶华微电子股份有限公司

董事会

2025年8月23日